

邮箱登录

用户名:

密 码:

[登录](#)

[所长信箱](#) [纪检信箱](#)

您现在的位置: 首页 > 新闻动态 > 综合新闻

“数模混合信号的可编程片上系统芯片研发”项目通过验收

撰写时间:2016-01-21 作者: 【字号: 小 中 大】 【点击率: 】 【打印本页】 【关闭】

2015年12月25日,科技部高新司信息领域办公室组织专家对电子所可编程芯片与系统研究室牵头的国家863计划“数模混合信号的可编程片上系统芯片研发”项目进行了现场验收。

科技部高新司信息处强小哲处长, 问斌副处长, 科技部高技术研究发展中心贾燕红主管, 电子所科技处李飞处长, 各承担单位负责人及代表参加了会议。验收专家组听取了项目首席科学家杨海钢研究员的项目验收报告, 现场查看了项目各承担单位的相关文档、资料、成果实物与演示, 并进行了质询, 认为该项目完成了立项批复规定的研究内容, 达到了要求的考核指标, 同意项目通过验收。

该项目由中科院电子所牵头, 下设五个课题, 分别由中科院电子所、西安电子科技大学、中国电子科技集团公司第二十四研究所、广州海格通信集团股份有限公司和成都泰格微博技术股份有限公司承担。主要面向智能电网、射频和超宽带通信等应用, 攻克数模混合可编程SoC架构和优化、芯片设计、芯片验证等关键技术。

项目在融合FPGA与FPAA的可编程片上系统架构、高速高精度ADC/DAC可编程技术及软件映射方法、可编程超宽带射频电路技术及宽带可调谐天线技术等方面取得了一系列创新成果, 并研制出三款数模混合可编程芯片原型, 执行期内申请国家发明专利40余项, 发表论文90余篇。(十一室 尹韬)



评论

相关新闻

网站地图 | 联系我们



@2008-2009 中国科学院电子学研究所 版权所有 备案序号：京ICP备05002787号 京公网安备110402500053号
地址：北京市海淀区北四环西路19号 邮编：100190 邮件：iecas@mail.ie.ac.cn

